

2026年 8 月14日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード)
代表者名：代表取締役 姜 輝
問合せ先：管理本部長 鎌田 文明
(T E L：045-317-7888)

「3次元 X 線 CT 撮像受託サービス」開始のお知らせ

— 非破壊で製品内部を3次元可視化し、研究開発・品質評価・不具合解析を支援 —

ウインテスト株式会社（以下「当社」）は、このたび、当社が培ってきた画像処理技術および検査技術を活用し、製品や部品の内部構造を破壊することなく3次元で可視化・解析する「3次元 X 線 CT 撮像受託サービス」（以下「本サービス」）を開始することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本サービス開始の背景

近年、電子部品、半導体、精密機器、自動車部品、樹脂成形品などの高密度化・小型化・複雑化が進む中、製品を分解・切断することなく内部状態を確認できる非破壊検査の重要性が高まっております。一方、3次元 X 線 CT 装置は導入コストに加え、設置環境や運用ノウハウが必要となることから、必要なときに必要な数量だけ撮像・解析を依頼したいというニーズもあります。

当社は、半導体自動検査装置の開発で長年培ってきた計測・画像処理・解析技術を生かし、こうしたお客様の研究開発、品質評価、故障・不具合解析等を支援するため、本サービスを開始いたします。

2. 本サービスの概要

本サービスでは、マイクロ CT X 線照射 3D 断層撮影検査装置「WTS-CT130」等を活用し、対象物を多方向から X 線撮影したデータをコンピュータで再構成することで、外観からは確認できない内部構造を断面画像および3次元画像として可視化します。

対象物を破壊せずに内部を確認できるため、試作品の評価、製造工程における品質確認、組立状態の確認、内部欠陥の調査、研究開発用途など、幅広い分野でご利用いただけます。撮像条件や解析内容については、対象物やお客様の目的に応じて個別にご相談を承ります。

3. 主な特長

① 非破壊で内部構造を確認

製品を切断・分解することなく、内部の構造や組立状態を確認できます。

② 断面画像と3次元画像による多角的な評価

任意方向の断面観察に加え、3次元画像による内部状態の把握が可能です。

③ CT装置を保有しないお客様も必要なときに利用可能

高額な装置導入や専用設備の準備を行うことなく、研究開発や品質評価に3次元X線CTを活用できます。

④ 当社の検査・画像処理技術を活用

半導体検査装置メーカーとして培った計測・画像処理技術を生かし、撮像からデータ提供までお客様の評価業務を支援します。

⑤ 業界の平均価格を大きく下回る価格破壊でサービスを提供いたします。下記【サービスに関するご案内】から当社WEBページを通じてご相談ください。

※ 本日より先着10名様に限り、特別限定価格3万円/件にて、お引き受けいたします。

4. 想定する利用分野

電子部品・半導体関連部品、基板・実装部品、精密機械部品、樹脂・複合材料、自動車関連部品、研究開発用試料などを対象に、内部構造の確認、組立状態の評価、空隙・亀裂等の確認、故障・不具合解析、試作品比較などへの利用を想定しております。

5. 今後の展開

当社は、本サービスを単なる撮像代行にとどめず、これまで培ってきた検査・計測・画像処理の技術力を活用した解析・評価サービスへと今後発展させてまいります。また、半導体・電子部品分野に加え、製造業、研究機関等への展開を進め、お客様の研究開発期間の短縮、品質向上および不具合解析の効率化に貢献するとともに、新たな収益基盤の構築を図ってまいります。

6. 業績への影響

本サービスの開始による当社の2026年12月期連結業績への影響は、現時点では軽微と見込んでおります。今後、業績に重要な影響を与えることが判明した場合には、速やかに開示いたします。

【サービスに関するご案内】

サービス名称	3次元X線CT 撮像受託サービス
サービス開始時期	2026年8月
詳細・お問い合わせ	当社WEBサイト「X線解析撮像代行サービス」ページをご覧ください。

以 上

本件については、以下のプレスリリースからもお読みいただけます。

[プレスリリース](#)

3次元X線CT 撮像受託サービス



130kV マイクロフォーカス X 線源と高解像度 CMOS FPD を搭載した WTS-CT130

5 μ m

最小空間解像度

$\leq 10\mu$ m

最大検出解像度

75 × 80mm

撮像可能エリア

130kV

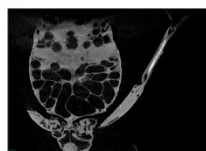
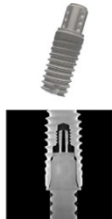
マイクロフォーカスX線源

◇ 幅広いサンプルに対応 ◇

PCB・電子部品	内部欠陥、ワイヤボンディング、BGA、接続状態の確認など。
LED	ひび割れ、気泡など内部状態の非破壊観察。
生体標本	解剖学・生理学用途などの内部構造観察。
プラスチック	クラック、気泡、内部空隙などの確認。
インプラント	根管、内部構造、接合状態などの観察。
地質サンプル	内部細孔のサイズ、形態、分布の観察。



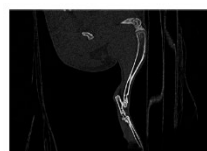
インプラント



昆虫



歯



ねずみ